

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于根据一般发行授权完成配售新 H 股的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已根据 2025 年年度股东会审议通过的《上海剑桥科技股份有限公司关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会增发 H 股股份的授权，于 2026 年 6 月 4 日完成新增发行境外上市股份（H 股）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般发行授权配售新 H 股的公告》（公告编号：临 2026-027）的定义一致。

### 一、完成配售

2026 年 6 月 4 日，本次发行的全部配售先决条件均已达成（包括取得香港联交所上市委员会就配售股份上市及买卖的批准），并于同日完成配售。公司于 2026 年 6 月 4 日成功按配售价每股配售股份 126.66 港元，向不少于六名承配人（据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方）配发及发行合共 15,600,000 股新 H 股，占经配发及发行配售股份扩大后的已发行 H 股总数约 16.84%。紧随配售完成后，概无承配人成为公司的主要股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）。

配售所得款项总额约为 1,975.90 百万港元，配售所得款项净额（经扣除配售佣金及其他相关成本及开支后）约为 1,966.97 百万港元。鉴于近期人工智能应用的蓬勃发展，高速光模块的需求显著增加，导致核心元器件出现短缺，例如 800G 及 1.6T 光模块所需的高速 DSP 芯片组、100G/通道及 200G/通道的硅光芯片组，以及 70mW 至 200mW 的连续波（CW）激光器件。该等核心元器件的交付周期大幅延长，且需支付定金或预付款以确保产能。鉴于上述情况，本公司一直计划在未来数年进一步储备核心元器件，以确保新扩充的产能得到充分利用，从而满足客户需求。本公司认为，配售所得款项净额将能为此目的提供稳定的财务支持。

因此，本公司将所得款项净额用作以下用途：（1）80%预期将用于核心元器

件的战略性储备；（2）10%预期将用于补充公司的营运资金；（3）其余 10%预期将用于其他一般企业用途。

## 二、对本公司股权架构的影响

截至本公告日期，本公司已发行 A 股总数为 275,588,373 股。本次发行完成后：（1）已发行 H 股总数由 77,062,000 股增加至 92,662,000 股；及（2）已发行 A 股总数维持不变，仍为 275,588,373 股。因此，本公司已发行股份总数由 352,650,373 股增加至 368,250,373 股。本公司于紧接配售完成前及紧随配售完成后的股权结构如下：

股东	紧邻配售完成前		紧随配售完成后	
	股份数目 (股)	占已发行股份总 数的比例	股份数目 (股)	占已发行股份总 数的比例
<b>A 股</b>				
已发行 A 股总数	275,588,373	78.15%	275,588,373	74.84%
<b>H 股</b>				
承配人	-	-	15,600,000	4.24%
其他公众 H 股股 东	77,062,000	21.85%	77,062,000	20.93%
已发行 H 股总数	77,062,000	21.85%	92,662,000	25.16%
已发行股份总数	352,650,373	100.00%	368,250,373	100.00%

注：由于百分比数字四舍五入至小数点后两位，上表所列百分比数字的总和未必等于所示相关小计或百分比数字的总和。

## 三、本次发行事项前后控股股东及其一致行动人持有公司股份的变化情况

公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited 及其一致行动人上海康令科技合伙企业（有限合伙）未参与本次发行，本次发行后合计持股比例由 10.34% 被动稀释至 9.90%。具体情况如下：

股东名称	变动前持股 数量 (股)	变动前持股 比例 (%)	变动后持股 数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
控股股股东及其一致行动人	36,458,211	10.34	36,458,211	9.90

(合并计算)				
Cambridge Industries Company Limited	31,125,735	8.83	31,125,735	8.45
上海康令科技合伙企业（有 限合伙）	5,332,476	1.51	5,332,476	1.45

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会  
2026年6月5日